

EPP

ELEKTRONIK PRODUKTION & PRÜFTECHNIK

10

OKTOBER 2014



Hans-Jürgen Hertel:

„Steigender globaler Wettbewerb ist mittlerweile kein Trend mehr, sondern anhaltende Realität.“

News & Highlights

Pressekonferenz im Siemens Elektronikwerk

Baugruppenfertigung

Welle oder Selektiv – (K)eine Entscheidung

Packaging

Einsatz von 2K-Materialien

Test & Qualitätssicherung

Röntgentechnologie für aktuelle Applikationen

Neue Materialien, neue Anwendungen

Wie automatische Profilingssysteme die Elektronikfertigung verbessern

Transparente Lötprozesse

SolderStar Ltd., Lancashire (UK)

Elektronische Baugruppen und ihre Herstellung werden zunehmend komplexer, damit wird auch der Ruf nach solchen Systemen immer lauter, die sehr hohe Anforderungen und Erwartungen in der Fertigung erfüllen, sei es um die Qualität abzusichern bzw. die Kosten zu begrenzen. Thermische Profilingssysteme, mit denen man traditionell optimale Temperaturverläufe für den Lötprozess definiert, haben in der Elektronikherstellung zu deutlichen Verbesserungen geführt.



Die Sensor Interface Unit von APS

Für die thermische Profilierung im Lötprozess werden an einer Baugruppe diverse Thermopaare angebracht und die Temperaturen an Baugruppe und Bauteilen per Messdatenlogger erfasst, gespeichert und ausgewertet. Solche Temperaturprofile zur Verifikation des Lötprozesses werden an SMT-Linien (Surface Mount Technology) mit einem Testboard und der Instrumentierung darauf regelmäßig vorgenommen.

Entwicklung im automatischen Profiling

Bis vor kurzem war das manuelle Temperaturprofilierung die bevorzugte Kontrollmethode. Doch durch Weiterentwicklung und Innovationen der automatischen Profilingtechnik können jetzt mehr Überprüfungen im Lötprozess vorgenommen werden, dies hat höhere Prozessqualität und weniger arbeitsintensive manuelle

Nacharbeit zur Folge. Der Bedarf für die wichtige regelmäßige Überwachung der Temperaturprofile war schon immer hoch. Weil man jedoch manuelle Systeme wegen des großen Aufwands nur in längeren Zeitabständen für Temperaturprofilierung einsetzen kann, mussten die Anwender darauf hoffen, dass sich zwischen diesen langen Abständen im Prozess keine ungünstigen Veränderungen ereigneten. Doch nicht nur diese Prozesskontrolle war unzuverlässig, bei jeder Messung mussten auch die laufenden Lötprozesse unterbrochen werden, um das aufwendige manuelle Temperaturprofilierung durchzuführen.

Zur Ablösung dieser ziemlich ineffizienten manuellen Methode wurde das SolderStar Automatic Profiling System (APS) entwickelt, es erschien zuerst System APS-1000 mit dem die Stabilität der Prozessparameter in Reflowöfen kontrolliert wurde. Obwohl das Gerät sehr robust und eine deutliche Verbesserung zum

manuellen Verfahren war, gab es immer noch einige Nachteile: die Reaktionszeit war zu langsam und zwischen einzelnen Temperaturzonen zeigten sich Konduktionsprobleme. Zudem war es in der Herstellung sehr anspruchsvoll und teuer, und nicht zuletzt zeigten sich Vertriebsprobleme in ausländischen Märkten. Die Abmessungen des Geräts waren groß und konnten zu unerwünschten Abschattungen am Board während des Ofendurchlaufs führen. Somit war trotz aller Verbesserungen dies keine ideale Lösung

Innovationsschritt zu noch effizienterer ASP

Das Unternehmen kreierte in einem nächsten Schritt das Profilingssystem APS-2000 mit einem verbesserten Erfassungsprozess und beseitigte die Nachteile des Vorgängermodells. Das System misst erstmalig die Stabilität der Prozessparameter zusammen mit der exakten Erfassung der Board-Position im Reflowofen. Mit diesem technologischen Durchbruch für die Fertigungsindustrie kann man nun für jede Baugruppe das am besten passende virtuelle Profil bestimmen. Die Lösung erfasst kontinuierlich die Position der Baugruppe und überwacht alle eventuellen Prozessänderungen am Produkt. Diese Änderungen zieht man heran, um mit einem mathematischen Modell das daraus resultierende PCB-Profil zu berechnen, das virtuelle Profil. Einzelne Prozessparameter lassen sich damit innerhalb der vorgegebenen Begrenzungen bestimmen und testen. Vor etwa zwei Jahren wurde das Konzept erneut überarbeitet und ein Redesign durchgeführt. Das ursprüngliche APS basierte auf der gleichen Instrumentierung wie im Profilingssystem eingesetzt. Die Erfahrung und weitere Entwicklungsarbeit zeigten jedoch, dass eine spezielle Instrumentierung für das System besser geeignet ist. Mit dem daraufhin neu entwickelten Messsystem für das APS-2000 konn-



APS-2000 bestimmt Temperaturprofile in Echtzeit

te die Zahl der benötigten Thermopaare deutlich reduziert werden. Das wiederum ermöglicht geringere Abmessungen der Probe, beispielsweise beträgt der Durchmesser für einen Ofen mit 16 Zonen typisch nur noch 6mm. Auch die Reaktionszeit ist nun sehr kurz, so dass eventuelle Maschinen- oder Prozessfehler rasch und einfach lokalisiert und beseitigt werden können. Die damit erzielbaren Einsparungen bei Zeitaufwand und Kosten sind enorm. Diese Prozessprobleme erfasst APS-2000:

- Falsche gesetzte Zonentemperatur – überprüft mit Referenz
- Falsch gesetzte Durchlaufgeschwindigkeit – überprüft mit Referenz
- Falsche Thermopaarsignale aus Ofenzonen
- Störungen an Ventilatoren
- Probleme mit dem Boardtransport
- Vom Bediener falsch geladene Ofeneinstellungen
- Überlast im Ofen-Durchsatz
- Thermisches Profil außerhalb der Prozessbedingungen.

Diese Kombination von hilfreichen Anwendungsvorteilen sorgt dafür, dass Elektronikhersteller damit sowohl in puncto Equipment und

Prozess beruhigt arbeiten als auch ihre Fertigungsprozesse fortlaufend optimieren können. Das ist auch der Grund, warum sich kürzlich beispielsweise zwei führende europäische Elektronikhersteller nach umfangreichen Evaluierungen für das Profilingssystem entschieden haben.

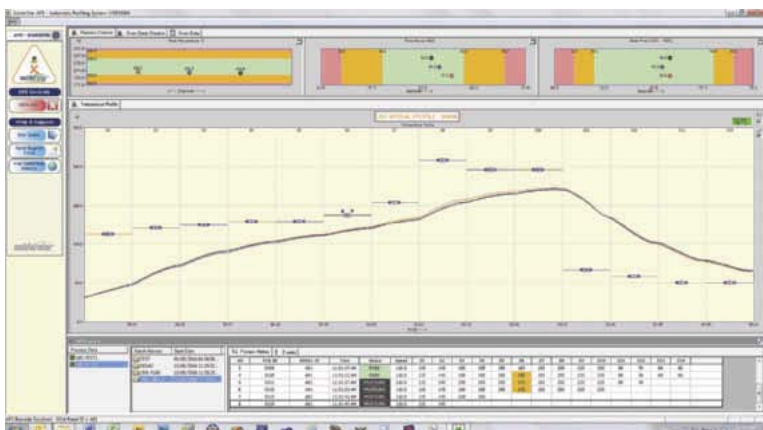
Es handelt sich um ein System, das uneingeschränkt rund um die Uhr für Überwachung und Profiling aller in einem Konvektions-Refloföfen gelöteten Baugruppe einsetzbar ist. Es ist so konzipiert, dass sich damit präzise die Anforderungen von Reflowöfen und Lötprozessen für jeden Anwender erfüllen lassen. Das System misst kontinuierlich die Zonentemperaturen am Produkt sowie die Transportgeschwindigkeit und vergleicht diese Messungen mit vorher spezifizierten Prozessreferenzen. Jede Messung wird fortlaufend mit den betreffenden Referenzen verglichen und somit eventuelle Abweichungen sofort erkannt und evaluiert. Sollte die Differenzen zwischen der aktuellen Messung und der Referenz die von Anwendern definierten Limits überschreiten, wird über die standardisierte SMEMA-Schnittstelle (Surface Mount Equipment Manufacturer's Association) in der

Lötanlage jeglicher weiterer Einlauf von Lotgut umgehend gestoppt, um die Produktion von fehlerhaft gelöteten Baugruppen zu unterbinden.

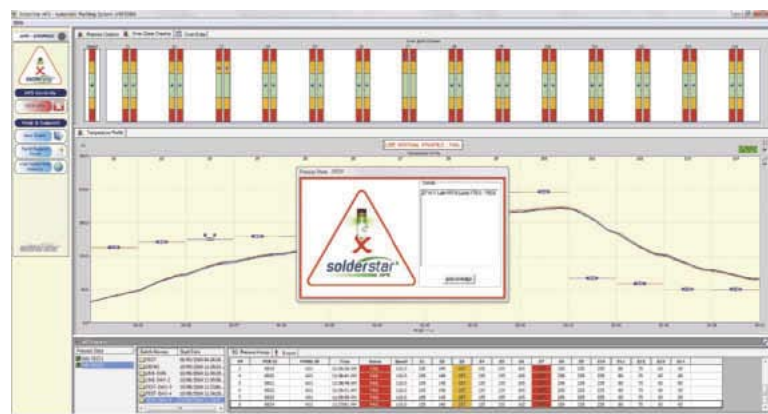
Spezielle Temperaturfühler sind entlang der Zonen auf beiden Seiten der Maschine angebracht, sie messen in Echtzeit die tatsächliche Temperatur am Produkt. Zusätzlich überwacht das System die Durchlaufgeschwindigkeit sowie die Position jeder Baugruppe im Prozess. Die Temperaturfühler mit ihren geringen Abmessungen sind ziemlich nahe der PCB angebracht, womit eine wesentlich präzisere Messung in der Umgebung der Baugruppe während des Lötvorgangs stattfindet. Die geringen Abmessungen reduzieren zudem mögliche Abschattungen am Board.

Sowohl die Temperaturen am Produkt als auch die Transportgeschwindigkeit werden unabhängig vom Ofen erfasst. Dafür gibt es zwei wichtige Gründe:

- a) Mögliche Ofenstörungen – Probleme in Heizelementen oder Gebläse
- b) Mögliche Bedienerfehler – für eine Baugruppe wurden die falschen Ofeneinstellungen geladen



Die Screenshots zeigen deutlich, wenn es Prozessprobleme gibt



In der Regel kontrolliert der Ofen selbst die Temperatur in jeder Zone. Die Messdaten dafür werden nahe an den Heizelementen abgenommen und nicht als Temperatur direkt am Produkt, die wiederum von der Ofenkonvektion abhängig ist. Für das System hingegen werden die speziellen Temperaturfühler möglichst direkt am vorbeilaufenden Produkt beidseitig der Transportmechanik installiert. Diese Sensoren messen ziemlich genau die realen Temperaturen, die auf das Lotgut einwirken und verursachen nur noch sehr geringe Abschattungen. Sobald



Mit dem neuen Messsystem werden weniger Thermopaar benötigt, was zu geringeren Abmessungen der Probes führt

eine Baugruppe in den Reflowofen einläuft, wird seine Fortbewegung lückenlos verfolgt und die Temperaturen am Board aufgezeichnet, welche die Sensoren in dieser Zone erfassen. Verlässt ein Board den Ofen wird umgehend das durchfahrene Temperaturprofil anhand der Echtzeitmessungen berechnet und der Referenz gegenüber gestellt. Damit ist eine sofortige, sehr genaue Gut/Schlecht-Aussage über den Lötvorgang möglich, diese wird zur leichten Kontrolle ebenfalls erfasst. Somit steht für jede einzelne Baugruppe eine lückenlose Aufzeichnung der Prozess-Durchlaufgeschwindigkeit, der einzelnen Zonentemperaturen und das daraus berechnete Profil zur Verfügung. Damit ist eine zu 100% uneingeschränkte Traceability für den Lötprozess als jederzeit aufrufbarer Nachweis vorhanden.

Traceability, Barcode und SMEMA-Integration

Ist eine Fertigung durchgängig mit Barcodesystem ausgerüstet, lässt sich das System in das ERP-System (Enterprise Resource Planning) des Herstellers integrieren, um die Daten aus der Fertigung der Baugruppen automatisch darunter abzulegen. Über diese Barcode-Integration können die Profile in der Datenbank den jeweiligen Baugruppen eindeutig zugeordnet werden, womit volle Rückverfolgbarkeit im Prozess sichergestellt ist. Über die SMEMA-Anbindung kann das APS-System auch unmittelbar in den Fertigungsfluss am Lötoven zur Kontrolle eingreifen. Diese ERP-Einbindung sowie die Steuerung des Lötovens sind in der hochvolumigen Elektronikfertigung zwei unverzichtbare Eigenschaften.

Zusätzlich lassen sich damit auch noch Produktwechsel in der Linie genau überwachen: Das Barcodesystem liest den Code einer Baugruppe aus und gibt diese Daten automatisch in das APS-2000 ein. Damit kann die Art der Baugruppe vom APS exakt bestimmt und gleichzeitig kontrolliert werden, ob die Ofeneinstellungen dafür korrekt sind.

Sollte das nicht der Fall sein, wird das Board noch im Ofeneinlauf zurückgehalten und der Maschinenbediener sofort informiert. Sobald dann für die betreffende Baugruppe die richtigen Ofeneinstellungen eingegeben sind, wartet das APS die Zeitspanne ab, bis alle Temperaturparameter stabil sind und gibt dann den Lötoven für den weiteren Prozeß wieder frei. Über den Barcode lassen sich die virtuellen (aus den Daten berechnete) Profile sowie alle Ofenwerte für jede Baugruppe erfassen und jederzeit später für die Rückverfolgbarkeit der Produktionsbedingungen aufrufen.

In folgenden Schritten bestimmt das APS-2000 Temperaturprofile in Echtzeit:

Schritt 1) Erfassen des tatsächlichen Temperaturprofils einer Baugruppe mittels Testboard und manuellem Profilingssystem. (Zur Eingabe in die APS-Software steht damit ein thermisches Modell des Ofens sowie von Bauteilen und Board bereit.)

Schritt 2) Analyse und Erfassung des „guten“ Zustands des Reflowofens.

Schritt 3) Das APS misst in Echtzeit alle Veränderungen im Prozessablauf. Die Daten aus den Schritten 1 und 2 werden dann zur Kalkulation des Profils herangezogen. Auch die Prozessparameter werden berechnet und gegen die spezifizierten Limits verglichen und getestet. Die Vorteile des APS-2000 im Überblick

- Kontinuierliche Überwachung von Reflowprozessen rund um die Uhr, ohne ständig wiederkehrendes manuelles Profiling.
- Klares und leicht verständliches Systemkonzept – Erst Prozess ablernen und dann testen.
- Einfach zu installieren und zu betreiben.

- Vom Anwender vorgegebene Prozesslimits ermöglichen einen unmittelbaren Stopp im Lötprozess, wenn Abweichungen über den Referenzwerten liegen.
- Automatische Verfolgung und Überwachung von Lötprozessen mit der lückenlosen Traceability für alle Baugruppen.

Warum ein APS in der Fertigung einsetzen?

Das System offeriert Elektronikherstellern alle nötigen Funktionen für ein effizientes thermisches Profiling ohne Zeitverluste. Damit lassen sich Prozessprobleme umgehend dann erkennen und somit leicht korrigieren, wenn sie auftreten. Damit ist sichergestellt, dass Ausfallzeiten, Ausschuss und der Zeitaufwand für Nacharbeiten äußerst gering sind, gleichzeitig sichert man damit Qualität und Zuverlässigkeit der Baugruppen sowie die Traceability der Fertigung ab.

Der ununterbrochene Betrieb des Systems vermeidet einen „blind“ durchgeführten Lötprozess. Für jede Baugruppe wird das thermische Profil erfasst und dieser entspricht uneingeschränkt den spezifizierten Daten. Als maßgeschneiderte Lösung trifft das System gezielt die Anforderungen aller Anwender, wobei sich die Fertigungskosten aufgrund von reduzierten Ausfallzeiten sowie geringerer Reworkaufwendungen deutlich reduzieren lassen.

Die Software des Unternehmens enthält einen speziellen Algorithmus zur Berechnung des thermischen Profils jeder Baugruppe. Herangezogen wird zur Kalkulation das Referenzprofil, gewonnen zu Fertigungsbeginn mit einem herkömmlichen Profilingssystem zusammen mit den Echtzeitdaten aus dem Prozess. Dieser Algorithmus wurde zusammen mit einer führenden mathematischen Kapazität optimiert, um noch genauere Ergebnisse über den Lötprozess zu erzielen. Das APS-2000 prüft die Temperaturprofile aller Boards, analysiert die Profile automatisch und kontrolliert die Parameter der Fertigung in Relation zu den Produktlimits. Die Software verfolgt zudem auch noch genau den Weg der Baugruppe durch den Ofen und ermöglicht somit höchstmögliche Genauigkeit in der Berechnung des Temperaturprofils einer Baugruppe.

Diese neueste Evolution des Systems hat bei großen, international tätigen Elektronikherstellern bemerkenswert großen Anklang gefunden. Die fortlaufende Weiterentwicklung des Systeme sowie neue und verbesserte Funktionen sorgen für noch größere Attraktivität und stellen einen wertvollen Nutzen sowohl für die global als auch eher lokal agierende Elektronikfertigung in ihrer gesamten Breite dar.

www.solderstar.eu